

日本企業の対外技術移転の現状

—テクノグローバリゼーションの観点から—

上山 邦雄・安田信之助
張 紀潯・新田 光重

目 次

- I 共同研究について
- II ハイテク貿易摩擦と半導体のプロダクト・サイクル
- III 日系製造業企業の対欧技術移転の現状と問題点
- IV 自動車産業のアジア諸国への技術移転の現状
- V 日本企業の対中技術移転の現状と問題点

I 共同研究について

19世紀に世界経済の中心はヨーロッパにあったが、20世紀には、とりわけ第一次世界大戦を境に、その地位はアメリカへと交替していった。第二次世界大戦はアメリカの世界経済における地位をさらに高め、資本主義世界におけるアメリカの一極的主導体制が確立した。ところが、こうしたアメリカ中心体制の基礎にあるアメリカの産業的覇権は、西欧や日本が戦後の復興・再建を完了し、1950年代半ばから高度成長を展開していくなかで、徐々に揺らいでいき、70年代以降、世界経済の多極化が進行していくことになった。さらに、80年代以降、途上国の工業化が急ピッチで進行し、アジアではNIES、アセアン、中国、その他の諸国という重層的発展構造が形成されている。

このような1970年代以降のアメリカの産業的覇権の崩壊の過程で、グローバルな技術的伝播の傾向が拡大してきた。60年代までの技術の流れは、欧米間においては双方向的な流れも存在していたが、基本的には、アメリカを中心とする欧米の技術優位国から技術劣位国への流れとして捉えられる。しかし、70年代以降、日本が欧米に対する技術供与国としても台頭し、日米欧の双方向的な技術的伝播が活発となるとともに、急速な成長をとげつつある途上国が技術の受け手として重要性を増してきた。

本稿は、こうしたテクノグローバリゼーションの一面に、主に日本企業の対外技術移転の現状

に焦点を当てて接近することを目的としている。簡単に内容を要約しておこう。

Ⅱ「ハイテク貿易摩擦と半導体のプロダクト・サイクル」(安田信之助執筆)では、半導体産業をとりあげ、日米を軸とした競争関係と摩擦の実態を明らかにし、併せて、この間の韓国の急速な接近についても考察する。Ⅲ「日系製造業企業の対欧技術移転の現状と問題点」(新田光重執筆)では、日本から欧州への領域間技術フローを統計的に集計し、日系製造業企業の対欧技術移転の現状と問題点を明らかにする。Ⅳ「自動車産業のアジア諸国への技術移転の現状」(上山邦雄執筆)では、近年急速に成長しつつあるアジアの自動車産業と日本の自動車産業を、技術移転という観点を中心に考察したものである。Ⅴ「日本企業の対中技術移転の現状と問題点」(張紀濤執筆)は、改革・開放政策を推進し、市場経済化を進めている中国をとりあげ、日本企業の対中技術移転の現状と問題点を指摘したものである。

(上山邦雄)

Ⅱ ハイテク貿易摩擦と半導体のプロダクト・サイクル

はじめに

半導体は産業のコメとして電気・通信産業の国際競争力を決定する極めて重要な産業である。それだけに、新製品の開発競争は激烈をきわめている。

1985年6月、わが国半導体メーカーの躍進と米国半導体メーカーの低落を背景として、米国半導体工業会(SIA)は、通商法301条(不公正貿易慣行)に基づいて、対日提訴を行った。そして、これに続いて一連のダンピング提訴調査が行われ、これを契機として、日米両政府間で半導体協議が開始された。

そして、86年9月に日本市場における外国系半導体の購入拡大(対日市場アクセスの改善)のための勧奨、ダンピング防止のためのモニタリングなどを内容とする日米半導体協定が締結されたのである。

また、同時にダンピング調査の対象となったDRAMとEPROMについて、コストに基づいて算定された一定の最低価格(FMV)以下では販売しない旨の約束(サスペンション・アグリーメント)が日本の半導体メーカーと米国商務省との間で締結されたのである。

具体的には、DRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)など主要メモリ製品を対象に、各社の生産コストに8%の営業利益を勘案した市場公正価格を策定した。これによって、ダンピングを防止するとともに、数量規制や輸入課徴金をもたらす弊害である製品価格の上昇を防ごうとしたのである。また、市場アクセスとして、わが国市場での外国製品の市場シェア20%の目標値を掲げ、日米で官民が協力する体制をつくったのである。